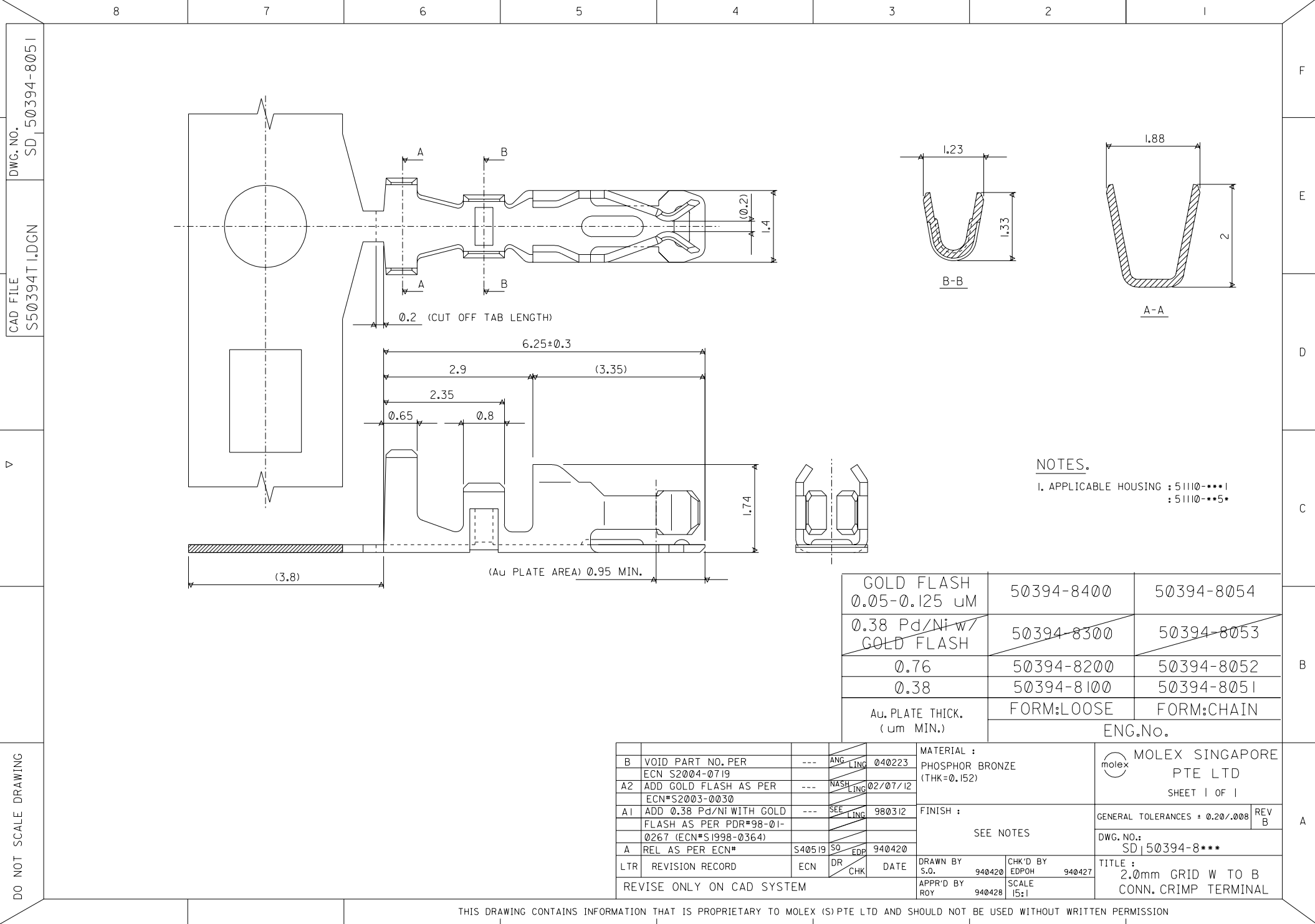




DWG. NO.
SD-50394-8051

E

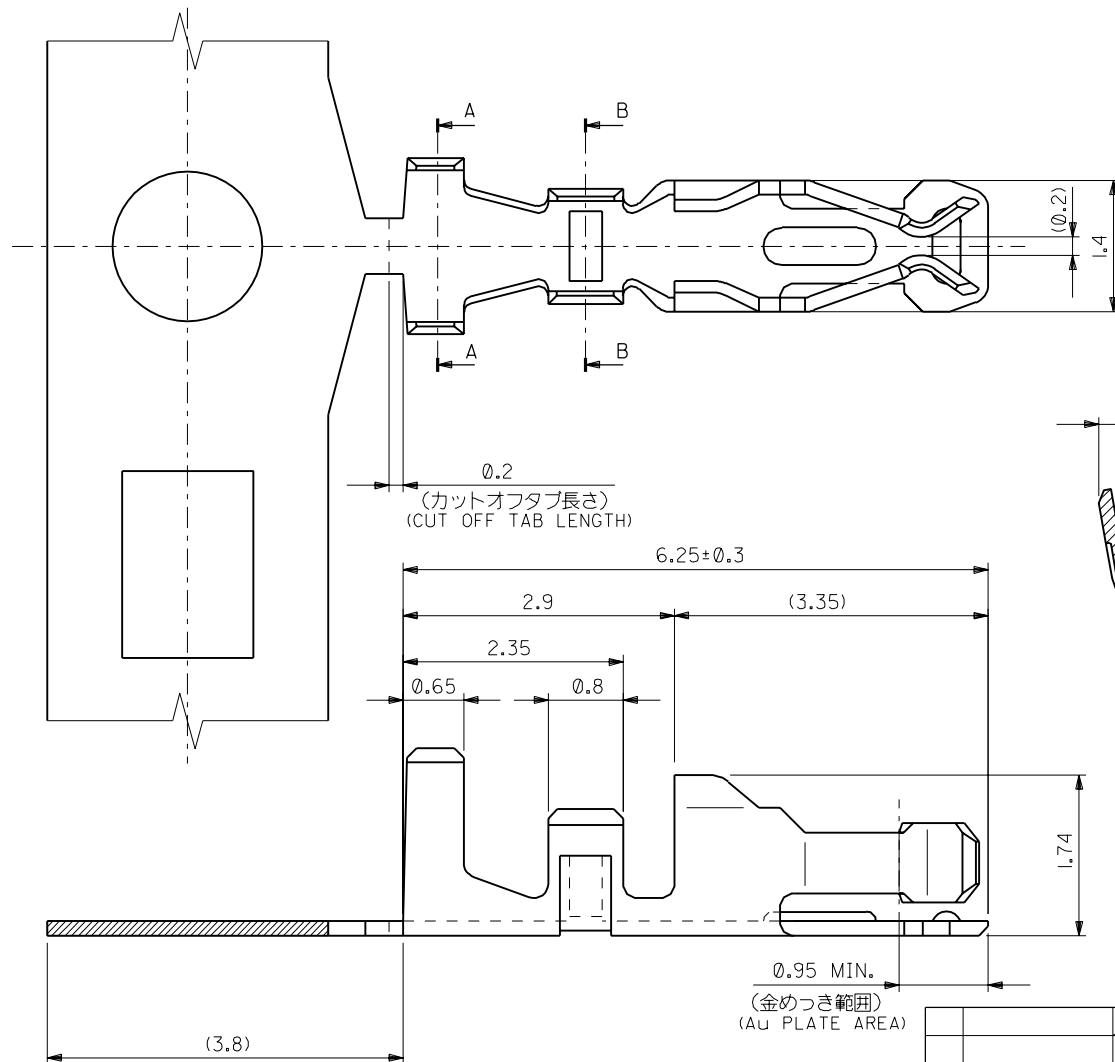
D

~MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

注)
NOTES.

- 適合ハウジング: 51110-***I
APPLICABLE HOUSING: 51110-***I
- めっき仕様
PLATING SPEC
ニッケル下地金のつき (0.38 μ m MIN.) 仕上げ
Au (0.38 μ m MIN.) OVER Ni PLATE



角度	ANGLE	$\pm 3^\circ$
30 以上	OVER	± 0.3
10 以上 30 未満	OVER UNDER	± 0.25
10 未満	UNDER	± 0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

記号	変更内容	DR.	日付	APPROV.	DATE
LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE	DATE	DATE

材料	MATERIAL
磷青銅 (板厚: 0.152)	PHOS.-BRON. (t=0.152)
仕上げ	FINISH
注) 参照	SEE NOTES
適用電線範囲	WIRE RANGE
#24 ~ #30	
被覆外径	INS. RANGE
$\phi 1.4$ MAX.	
DRAWN BY	CHK'D BY
Y.1	Y.1
93/05/08	93/05/08
DATE	DATE
尺度	SCALE
20-1	

連鎖状	50394-8051
CHAIN	
端子形状	製品番号
TERM. FORM	ENG.NO.
molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	
日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
2.0mm GRID W TO B	
CONN. CRIMP TERMINAL	
DWG. NO.	REV
SD-50394-8051	0